

电子元器件行业：周报（2018.3.5-2018.3.11）

2018年3月12日

ARM、高通等投入研发 智能手机自体 AI 时代即将启航

看好（维持）

㊦ 上周市场表现

上周 A 股整体小幅上涨，沪深 300 指数涨幅为 2.30%，收报于 4108.87 点。电子元器件板块表现强于市，电子元器件（中信）涨幅为 4.73%，收报于 6149.26 点。

㊦ 行业观点

我们首先看好半导体板块，重点为被动元器件、上游材料设备、下游封测板块；其次看好安防、智能硬件等板块。

㊦ 业内动态

ARM、高通等相继投入研发 智能手机自体 AI 化时代即将启航

苹果明年要放弃“刘海”式设计 推真正全面屏 iPhone

AI 芯片向中端转移，华为麒麟 670 将导入 AI 架构

华尔街日报：英特尔正考虑收购博通

重庆万国半导体预计 3 月试生产每月可生产 5 万片芯片；

台积电 2 月营收写十个月新低，3 月营收将突破千亿元

国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到 2019 年

大反转！Cree 3.45 亿欧元并购英飞凌射频功率业务

近 9 年全球 92 座 IC 晶圆厂关闭或移为他用 利于代工模式发展

硅晶圆涨价不止，客户抢签长期合约以确保产量

部份关键设备停产 8 英寸晶圆代工价格逐季调涨

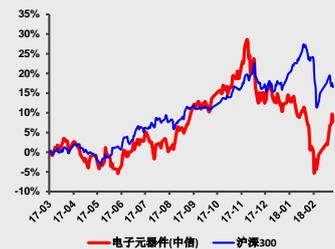
传三星 OLED 面板产能利用率降到 50%至 60%

确保优势，京东方拟近千亿元投建第 6 代 AMOLED 生产线等三项目

㊦ 风险提示

行业景气度衰竭；宏观经济复苏弱于预期；市场震荡与风格切换引起的估值变化

市场表现 截至 2018.3.11



分析师：庞立永

执业证书号：S1490515090001

联系人：史团伟

电话：010-85556180

邮箱：shituanwei@hrsec.com.cn

证券研究报告

目 录

一、上周市场回顾.....	4
1、A股：市场整体小幅上涨，电子板块强大于市	4
2、海外市场	5
二、行业动态.....	6
1、消费电子板块.....	6
2、半导体板块	11
3、显示面板行业.....	20
三、产品行情指标.....	24
1、半导体方面指标.....	24
2、面板方面指标.....	25
3、消费电子方面指标.....	26
四、投资策略.....	26
五、风险提示.....	26

图表目录

图表 1: 电子元器件板块近一年市场表现.....	4
图表 2: 电子元器件板块上周涨跌幅前五股票.....	4
图表 3: 电子元器件板块年初至今涨跌幅前五股票.....	5
图表 4: 台湾市场电子板块近两年市场表现.....	5
图表 5: 美国市场半导体板块近两年市场表现.....	5
图表 6: 北美半导体设备出货额 (百万美元)	24
图表 7: 日本半导体设备出货额 (单位: 百万日元)	24
图表 8: 全球半导体月销售额.....	24
图表 9: 全球液晶电视面板出货量	28
图表 10: 全球 PC 面板出货量	25
图表 11: 全球显示器面板出货量.....	25
图表 12: 全球 PC 出货量	29
图表 13: 全球智能手机出货量.....	26
图表 14: 全球平板电脑出货量.....	26

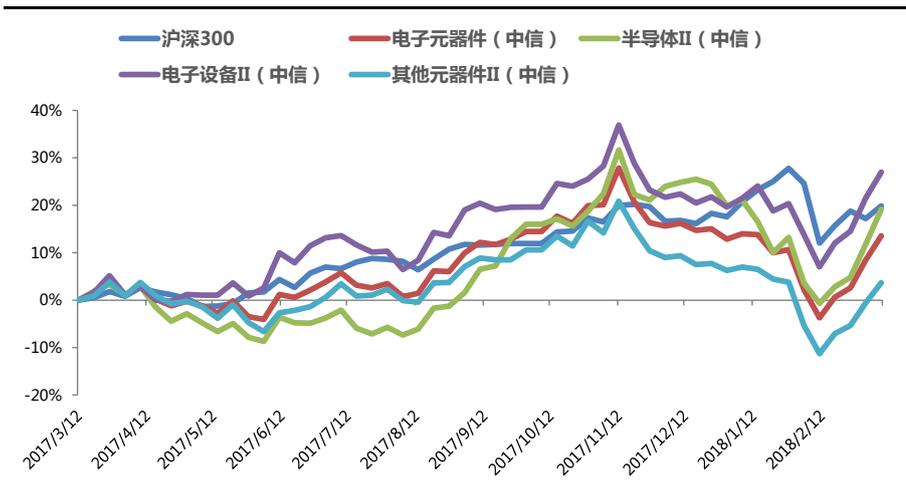
一、上周市场回顾

1、A股：市场整体小幅上涨，电子板块表现强大于市

上周 A 股整体小幅上涨，沪深 300 指数涨幅为 2.30%，收报于 4108.87 点。电子元器件板块表现强大于市，电子元器件（中信）涨幅为 4.73%，收报于 6149.26 点。

电子行业各子板块均大幅上涨，其中半导体 II（中信）上涨 6.57%，电子设备 II（中信）上涨 4.47%，其他元器件 II（中信）上涨 4.25%。

图表 1：电子元器件板块近一年市场表现



数据来源：wind，华融证券

电子元器件板块本周涨幅居前五的为深华发 A（000020）、天华超净（300390）、通合科技（300491）、江丰电子（300666）、瀛通通讯（002861）；跌幅居前五的为利达光电（002189）、铜峰电子（600237）、中科三环（000970）、正海磁材（300224）、三利谱（002876）。

图表 2：电子元器件板块上周涨跌幅前五股票

代码	简称	一周内涨跌幅	代码	简称	一周内涨跌幅
000020.SZ	深华发A	45.70%	002189.SZ	利达光电	-10.73%
300390.SZ	天华超净	37.40%	600237.SH	铜峰电子	-3.66%
300491.SZ	通合科技	20.79%	000970.SZ	中科三环	-3.11%
300666.SZ	江丰电子	20.47%	300224.SZ	正海磁材	-2.27%
002861.SZ	瀛通通讯	17.69%	002876.SZ	三利谱	-1.67%

数据来源：wind，华融证券

图表 3: 电子元器件板块年初至今涨跌幅前五股票

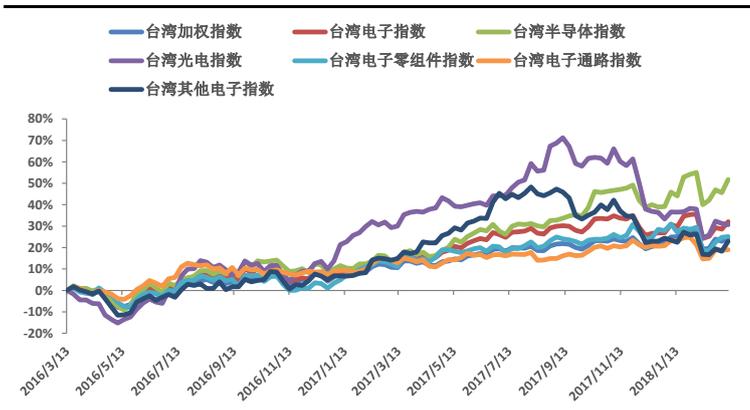
代码	简称	年初至今涨跌幅	代码	简称	年初至今涨跌幅
603595.SH	东尼电子	37.79%	002504.SZ	*ST弘高	-44.66%
300476.SZ	胜宏科技	31.11%	600654.SH	*ST中安	-36.86%
300390.SZ	天华超净	30.54%	603659.SH	璞泰来	-28.27%
000020.SZ	深华发A	27.99%	300220.SZ	金运激光	-28.04%
002236.SZ	大华股份	26.89%	603703.SH	盛洋科技	-26.59%

数据来源: wind, 华融证券

2、海外市场

上周海外市场表现: 台湾加权指数上涨 1.56%, 台湾电子指数上涨 2.74%; 美国纳斯达克指数大涨 4.17%, 费城半导体指数大涨 4.94%。

图表 4: 台湾市场电子板块近两年市场表现



数据来源: wind, 华融证券

图表 5: 美国市场半导体板块近两年市场表现



数据来源: wind, 华融证券

二、行业动态

1、消费电子板块

传大陆年底前关闭境内所有矿场

大陆官方传将对比特币等虚拟货币出重拳，要求今年年底前关闭大陆境内所有矿场、断绝所有挖矿业务，甚至可能提前在两会后祭出趋严的管理手段，为虚拟货币后市埋下变量。

近期智能手机、平板等终端产品需求不振，比特币等虚拟货币热潮兴起，为一线科技大厂注入暖流，不仅台积电等晶圆代工厂受益大，也带动晶豪科、旺宏等内存芯片厂，以及创意等硅 IP 服务商，还有微星、撼讯等板卡厂业绩暖呼呼。

业界指出，虚拟货币堪称近期全球科技业与股市人气指针，牵涉的行业类别从晶圆代工、内存等大型产业，到板卡、硅 IP 等周边次产业，大陆又是比特币等虚拟货币庞大的挖矿订单来源，一旦大陆官方出重拳要求关厂并采取严厉管理，不仅将影响比特币交易行情，更将牵动相关科技厂商业绩，影响甚大。

中国人民银行行长周小川日前于两会期间的谈话，已透露大陆官方对虚拟货币态度的风向球。他说，数字货币如果可投机，让人有一夜暴富幻想，不是好事；而虚拟资产交易在中国并不符合服务实体经济的方向，未来对虚拟货币将进行动态监管。

大陆官方管理趋严的氛围日益扩大，近期已有不少比特币玩家在微博上讨论此事，当地挖矿机主力供货商对外态度也转趋低调。

全球比特币挖矿龙头比特大陆创办人吴忌寒则透露，对监管单位持乐观态度，但也不讳言比特大陆为此，正研拟措施以因应风险，规划进军人工智能(AI)芯片、加强区块链领域投资，同时加速海外布局。

比特大陆之前已在旧金山、以色列和荷兰等地设立研发中心，2018年初，公司在海外布局的步伐明显加快，相继在瑞士设立分公司，并在新加坡建设地区总部。另有消息称，比特大陆正在加拿大寻找合适地点开始新矿场。

市场人士认为，吴忌寒释出的讯息与比特大陆的相关布局，隐约透露已意识到比特币早晚会遭官方严加管制，因此比特大陆要想办法找新出口因应。

据了解，大陆官方继去年9月要求关闭境内虚拟货币交易所后，传出下令关闭当地的比特币挖矿业务，时间点落在今年底。

另外，大陆现正举行政协和人大的「两会」会议，市场盛传两会后可能对虚拟货币祭出新政策，不排除提前严打，这个消息也让当地挖矿机业者近来更加

谨慎，正密切观察政策动向。经济日报

(资料来源：集微网)

上汽集团携手英飞凌成立功率半导体合资企业

集微网消息，上海汽车集团和英飞凌科技宣布成立合资企业，合资公司名称为上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司，由上汽集团持股 51%，英飞凌持股 49%。企业总部设于上海，生产基地则位于英飞凌无锡工厂扩建项目内，预计于 2018 年下半年开始量产。

英飞凌负责业务运营的董事会成员 Jochen Hanebeck 表示，该公司与中国最大的汽车制造商上汽集团携手合作，将进一步巩固和加强市场地位、扩充产能，从而满足迅速增长的市场需求。同时，凭借为中国电动汽车产业需求量身定制的产品，将共同拓展更多业务，此项合作将使该公司得以更加快速地服务中国的电动汽车客户。

上汽集团总裁陈志鑫表示，英飞凌在汽车功率模块领域声誉卓著，该公司对此次合作感到非常高兴，也深具信心，相信英飞凌先进的功率模块解决方案将与该公司在电动汽车整车和系统领域专业技术完美融合。电动汽车不仅能为客户提供极高的便利性和绝佳的驾驶体验，还能有效缓解能源和环境压力。

该合资公司旨在为中国生产的客户提供更加便捷、更加优质的服务和体验，为中国电动汽车市场提供功率解决方案。该合资公司主要为中国市场生产汽车级框架式 IGBT 模块 HybridPACK。

(资料来源：集微网)

ARM、高通等相继投入研发 智能手机自体 AI 化时代即将启航

不再依赖云端或服务器系统的智能手机，可以自己直接执行人工智能(AI)功能，未来也许不再是梦，因为一种“基于装置的机器学习”(on-device machine learning)时代正在开启。韩媒 ChosunBiz 引述业界消息，指出以 2018 年为起点，三星电子(Samsung Electronics)、华为与联发科等业者，预料将相继推出支持机器学习的移动应用处理器(AP)。

过去一段时间以来，机器学习多透过高阶中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)等复杂硬件实现。然而，高通(Qualcomm)从 2015 年开始，透过一项名为 Zeroth 的研发计划，期望利用移动系统单芯片(SoC)，有效率且自动执行机器学习，目标是将机器学习芯片搭载至智能手机或机器人等装置上。

换句话说，这将让搭载高通 Snapdragon 移动芯片组的装置，可对影像、物

体与人脸进行分类与辨识，如果这些功能皆能在装置内部实现，未来装置将不再依赖云端或通讯网路提供的 AI 服务。

目前全球移动芯片架构设计，99% 以上掌握在英国 Arm(ARM)手中。2017 年 Arm 发表具机器学习功能的移动芯片架构设计 DynamIQ，在芯片内部加入 AI 加速器，相较目前最新款移动处理器，理论上功能可望提升 50 倍以上。

Arm 韩国高层表示，智能手机与 PC 等消费者常用装置，如果出现一套可行的 AI 生态系，装置处理资料的速度可望更快，而 Arm 的目标，就是让搭载 Arm 架构芯片的智能手机等装置，可以进行快速且有效率的机器学习。

预料照 Arm 标准架构设计的许多移动 AP 业者，2018 年将纷纷推出相关新产品。三星、联发科等全球领先移动 AP 业者，目前皆采 Arm 架构设计，至于高通、苹果(Apple)的 AP，则是部分变更 Arm 架构设计，基本上使用的架构设计雷同。

移动装置如果正式进入 AI 时代，对韩国存储器业者也是一个大好机会。韩国学者指出，基于装置的深度学习，已是无法避免的时代潮流，韩国企业应该将其视为一个机会，努力思考其中的各种可能性。对于移动装置业者而言，也可视为目前市场成长停滞的解药之一，而移动处理器功能大幅跃升将带动软件进化，超高速 DRAM 与大容量 NAND Flash 需求也会增加。

另一方面，由于支持移动装置机器学习的半导体架构设计，大部分仍掌握在高通、Arm 手中，中长期而言，三星、乐金电子(LG Electronics)等韩国智能手机业者，付出的授权费有可能增加。韩国半导体业界相关人士表示，三星每年付给 Arm 巨额授权费，如果未来 Arm 在移动装置机器学习领域先行突围，到时三星对 Arm 的依赖程度，恐怕将比现在更为加深。

(资料来源：集微网)

苹果明年要放弃“刘海”式设计 推真正全面屏 iPhone

新浪科技讯 北京时间 3 月 7 日晚间消息，韩国媒体今日援引业内人士的消息称，苹果公司（以下简称“苹果”）计划在 2019 年推出的 OLED 版 iPhone 中取消当前 iPhone X 的“刘海”式屏幕设计。

报道称，苹果已决定在明年取消“刘海”式设计，并且已开始和供应商讨论相关技术问题。这意味着明年的 OLED 版 iPhone 有可能是一款真正的全面屏手机。

知情人士称，目前 2019 年款 iPhone 的具体规格尚未确定，包括屏幕尺寸

分辨率和新的屏幕形状等。但基于业界当前的发展方向，整个 iPhone 正面很可能就是一整块屏幕。

如果这样，屏幕正面就没有空间来容纳听筒或前置摄像头。另外，苹果还要保留 Face ID 面部识别功能。为此，业界对苹果未来的解决方案就十分关注。一些屏幕行业的专家认为，苹果可能对 OLED 面板进行钻洞，或者是利用屏幕内的黑色矩阵。

在苹果准备抛弃“刘海”式设计的同时，竞争对手对争相使用这种设计。在 2 月底的世界移动通信大会(MWC)上，华硕就推出了采用“刘海”式设计 ZenFone 5。此外，LG 和中国智能手机厂商也要推出基于这种设计的手机产品。

根据媒体之前的报道，苹果今年将推出三款 iPhone，其中两款采用 OLED 屏幕，屏幕尺寸分别为 5.85 英寸 和 6.46 英寸；而另外一款采用 LCD 屏幕，屏幕尺寸为 6.04 英寸。(李明)

(资料来源：集微网)

AI 芯片向中端转移，华为麒麟 670 将导入 AI 架构

集微网消息，继华为去年发布麒麟 970 高端芯片中导入 AI 架构后，日前传出华为海思将推出的麒麟 670 中端芯片也将导入 AI 架构。华为麒麟 970 芯片内置神经网络单元 (NPU)，运算能力达 1.92TFP 16 OPS，配备全球首款配备 4.5G 基带芯片，强大的芯片性能带动了华为手机出货量持续拔高。

据全球知名市场研究公司 IDC 日前发布的 2017 年全球智能手机品牌市场数据报告，该报告显示，2017 年全球智能手机品牌出货量达 14.724 亿台，环比 2016 年下降 0.1%；其中，华为 2017 年手机增速为 9.9%，手机出货量为 1.531 亿台，仅次于苹果。

而随着全球手机市场增速放缓，华为想要扩大手机市场的战果，将 AI 芯片从高端向中端下沉转移，势必可以带来更好的产品性能，同时也可以借测差异性拉抬中端智能手机的市占率，因此华为海思将要发布的麒麟 670 中端芯片导入 AI 架构也就显得合情合理。

事实上，华为自 2017 年发布的麒麟 970 高端芯片中，导入了 AI 架构之后，这使得华为在高端智能手机市场备受关注，且取得优异成绩。而麒麟 670 是华为在中低端市场面临竞争对手的激烈的价格竞争下所推出的产品，因此业界预估，麒麟 670 在导入 AI 架构之后，将能以差异化策略巩固自身优势。

据悉，华为麒麟 6XX 系列芯片被广泛用于旗下的中低端智能手机当中。其中，麒麟 670 是麒麟 6XX 系列最新的一款产品，其将采用两个 A72 核心 + 4 个 A53 核心的架构，GPU 为 Mali G72 MP4，以台积电的 12 纳米 FinFET 制程来生产。在性能方面，较上一代的麒麟 659 大幅提升。其中，最值得关注的，就是它也将引入在麒麟 970 上获得好评的 NPU 功能，将拥有 AI 架构。

未来，麒麟 670 芯片拥有 AI 架构之后，让华为可以避免继续与小米进行价格战，达到差异化竞争的目标，也获得更佳的出货量。至于，在中端手机市场上，华为对比 OPPO、vivo 两家竞争对手，其搭载麒麟 6XX 系列芯片所推出的 Nova 品牌，在 2017 年出货量达到 2,000 万支。而未来在 AI 芯片的帮助下，Nova 品牌将有望取得更多的出货量，进而在中国市场上继续与 OPPO 和 vivo 竞争。

此外，在刚刚过去的 MWC 2018 中，包括联发科新推出的 Helio P60 芯片，以及高通推出的骁龙 700 系列芯片都搭载 AI 架构，而这两款搭载 AI 架构的芯片又是针对中端智能手机市场而来。其中，Helio P60 芯片已经获得 OPPO、vivo 两家厂商搭载在 2018 年新推出的手机当中。因此，市场人士预估，这也是迫使华为不得不将 AI 架构下沉到中端麒麟 670 芯片的原因。由此来看，2018 年中端芯片搭载 AI 架构将成潮流，AI 智能手机的竞争也势必更加激烈。

（资料来源：集微网）

Arm 发布新一代 GPU Mali G52/G31，加入机器学习能力

集微网 3 月 6 日报道今天，Arm 在北京正式发布了旗下最新一代 Mali 多媒体套件，包含全新的视频、显示和图像处理。新的 IP 套件可与现有基于 DynamIQ 的 CPU 和其他 Arm IP 无缝集成，从而全面实现 Arm 新一代针对主流移动设备和数字电视（DTV）的解决方案。具体产品包括，针对主流手机的 Mali-G52 GPU，最大亮点加入机器学习能力；针对入门手机 Mali-G31 GPU 是目前最小产品；以及 Mali-D51 显示处理器和 Mali-V52 视频处理器。2017 年出货 1.2 亿颗 Mali GPU

在芯片界 Arm 扮演基石角色。据 IDC 报告显示，当今市场上，90% 以上配备 AI 的智能终端都基于 Arm 架构。官方数据显示，目前基于 ARM 的芯片总交付量超过 1250 亿，预计到 2021 年将达到 2000 亿。Arm 拥有超过 1,000 家技术合作伙伴，所涉及领域包括芯片、网络和云。

凭借高性能低功耗的特性，Arm 在多个领域都具备绝对优势。在 GPU 领域，仅在 2017 年公司旗下的 Mali GPU 出货量就高达 1.2 亿颗。

Arm 资深市场营销总监 Ian Smythe 表示，对终端设备而言，支持丰富的多层用户界面以及一系列广泛的最新应用已成为必然趋势。更为重要的是，机器学习不再是高端智能手机的专有配置。各级用户都希望轻松使用配备机器学习功能的各类 APP 应用，3D 游戏、混合现实和 4k 内容越来越流行，新型的游戏也不断出现在主流手机上。在新一代用户的需求之下，Arm 以技术驱动创新，推出新一代解决方案，为用户提供更酣畅的视觉体验。”

全新一代 GPU Mali G52/G31 发布，强调机器学习

首先从 Arm 公布的 GPU 产品路线图看，其在高中低端已经实现全布局，包括 G70 系列代表高端、G50 系列代表中端、G30 系列代表低端。

今天发布的 Mali-G52 GPU 定位中端产品，但是 Arm 的目标是让主流设备实现高级功能。与上一代产品 G51 相比，G52 可从容应对更高的图形复杂度，允许在主流移动系统的功率和带宽限制内实现更多的机器学习功能。

据悉，Mali-G52 采用更宽的执行引擎，相比前代产品的 4 线程，Mali-G52 最多可提供 8 线程，可在相同芯片面积上，提供更高的图形性能。

实测数据显示，相比上一代，G52 性能密度提高 30%，能效提高 15%，可降低设备的功耗和散热，并支持更长的游戏时间，甚至可支持 AR 等高耗电技术。

另外，Mali-G52 GPU 还加入了机器学习能力。Arm 官方表示，在主流设备中，专门去设置机器学习处理器的方法不太实际，这些任务可以由片上系统（SoC）的每个组件发挥其最佳性能实现，并与 DynamIQ CPU 和 Mali-G51 结合起来提升现有应用的机器学习性能。

另一款 GPU 产品 Mali-G31 是 Arm 全新一代针对低端产品而设计的，其定位为在最小芯片面积上提供卓越的用户体验。

据悉，Mali-G31 是第一款基于创新 Bifrost 架构的超高效 GPU（Ultra-Efficient GPU），也是 Arm 目前最小的处理器，支持 OpenGL ES 3.2 和最新一代 Vulkan API，开发人员可将其应用于数百万设备上。

另外，Mali-G31 较上一代采用 Bifrost 架构的 G51 尺寸缩小 20%，性能密度提升 20%，在减少芯片面积的同时显著提升能效。

（资料来源：集微网）

2、半导体板块

华尔街日报：英特尔正考虑收购博通

腾讯科技讯 3 月 10 日消息，据外媒报道，《华尔街日报》援引知情人士的话报道称，英特尔（Intel）正在考虑一系列收购方案，包括收购芯片制造商博通（Broadcom）。

在上述信息公布后，英特尔股价在盘后交易中下跌了 1%，而博通股价上涨逾 6%，高通股价几乎没有变化。

英特尔有意收购的消息传出之际，博通正积极寻求对高通的敌意收购。如果交易能够成功，合并后的公司成为英特尔的更大竞争对手。

消息人士在接受《华尔街日报》采访时表示，如果博通收购高通的交易可能成功，英特尔或会考虑向博通发出收购要约。然而，这些消息人士表示，这样的收购没法保证。甚至有人宣称，这是不可能的。

英特尔女发言人表示，该公司不会对交易传言置评。她在声明中称：“在过去的30个月里，我们进行了多项重要收购，包括Mobileye和Altera。我们的重点是整合这些收购，让它们为我们的客户和股东受益。”

博通没有立即回应记者的置评请求。但有报道称，博通对高通的竞购已经陷入困境，可能不得不暂时放弃当前交易，并在稍后卷土重来。

另据路透社报道称，当被问及媒体报道的潜在的收购博通一事，英特尔称，公司关注点在整合之前的诸多并购。

公司已经在过去30个月里实施了重大的并购交易，将侧重于让那些并购交易取得成功。

英特尔拒绝置评与收购和兼并相关的臆测。

此前，美国财政部下属外国投资委员会(CFIUS)已经对博通收购高通的交易表示出担忧，这对尚未正式宣布或同意的交易来说是史无前例的。

但知情人士宣称，博通预计不会放弃竞购目标。该公司将试图与监管机构达成和解，并解决他们的担忧。

在判断是否批准交易时，监管机构通常会咨询行业内部认识。知情人士称，微软和谷歌等科技巨头也对这笔交易感到担忧。

消息人士称，这些公司对苹果在交易中发挥的潜在影响力表示担忧，同时担心博通削减成本和不愿投资新技术的名声。(编译/金鹿)

(资料来源：集微网)

重庆万国半导体预计3月试生产每月可生产5万片芯片；

近日，从重庆两江新区传出消息，位于该区的重庆万国半导体科技有限公司预计今年3月开始试生产。该项目全面达产后，每月可生产5万片芯片、封装测试12.5亿颗半导体芯片，年产值将达10亿美元。

2015年9月，两江新区管委会与万国半导体科技有限公司(以下简称AOS)签订“12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目投资协议”，同时，AOS与重庆市战略基金、两江战略基金达成合资经营协议，于2016年4月22日成立重庆万国半导体科技有限公司(以下简称重庆万国)，注册资本3.3亿美元。该项目位于重庆两江新区水土工业开发区，总投资10亿美元，占地面积约22万平方米，具备生产销售、芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链能

力，将分两期建设。其中，项目一期投资约 5 亿美元，预计每月生产 2 万片芯片、封装测试 5 亿颗芯片；二期投资约 5 亿美元，届时预计每月生产 5 万片芯片、封装测试 12.5 亿颗半导体芯片。

重庆万国相关负责人介绍，目前，项目厂房已完成封顶，正在进行机电安装。预计今年 3 月，封装测试厂将开始试生产；今年第三季度，晶圆厂将开始试生产；今年年底，所有工程将全面完工、开始投产。

重庆万国项目将助力重庆打造国家重要集成电路产业基地，促进重庆电子信息产业从笔记本、电脑基地到“芯屏器核”智能终端的全产业生态链布局。

AOS 成立于 2000 年 9 月，总部位于美国加利福尼亚州硅谷。该公司是全球第一家从事电力功率半导体研发和生产的高新技术企业，集半导体设计、晶圆制造、封装测试于一体，主要从事功率半导体器件的产品设计和生产制造，产品涉及笔记本电脑、液晶电视、智能手机、家电、通信设备、工业控制、照明应用、汽车电子等领域，2017 年营业额近 4 亿美元。中国电子报

(资料来源：集微网)

台积电 2 月营收写十个月新低，3 月营收将突破千亿元

集微网消息，台积电今(9)日公布今(2018)年 2 月合并营收约为 646.41 亿元，较上月减少了 18.9%，较去年同期减少了 9.5%，创十个月来新低；累计今年前 2 月营收约为 1,443.81 亿元，较去年同期减少了 2.5%。

根据台积电日前公布的财测，第一季合并营收在 84 亿美元至 85 亿美元之间，以汇率基准 1 美元兑 29.6 台币计算，第一季营收将落在台币 2,486.4 亿元至 2,516 亿元间；而若财测预估不变，以目前台积电 1、2 月业绩达成状况来看，则台积电 3 月营收将达到突破千亿元大关的新高水准。

近日，台积电已向竹科管理局提出土地需求申请获准，启动竹科新研发中心建设，最快明年下半年动工。据悉，台积电竹科新研发中心总投资高达上千亿元，再加上今年 1 月下旬动土的南科新建晶圆 18 厂、竹科总部 5 纳米厂，以及后续 3 纳米投入的资金，台积电未来在高端制程将投入近万亿元人民币。

(资料来源：集微网)

国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到 2019 年

集微网消息，国巨董事长陈泰铭 8 日表示，这波被动组件需求不是来自单一杀手级产品，而是整体产业结构改变，加上供货商节制扩产，预估景气强度将延续较久，2018 年至 2019 年都审慎乐观。

国巨先前已先公布去年财报，去年第4季毛利率一举攻上43.7%，年成长19个百分点，不仅笑傲台系被动组件同业，甚至比没有工厂的IC设计龙头联发科的37.4%还多出6.3个百分点，陈泰铭在法说会开始便强调，毛利率的拉升主要来自于产品组合优化和新产能开出，涨价效应仅占一小部分。

陈泰铭指出，若毛利率拉升是来自涨价效应，同样涨价的被动组件同业表现应该一致；但由去年第4季营运成果来看，国巨的营收和毛利率成长幅度远优于其他同业，代表是本身产品组合优化和新产能开出所贡献。

业界关心这一波被动组件荣景能够延续多久？陈泰铭以1987年至1988年、2000年两波被动组件大行情为例指出，前两次需求拉升都是来自市场出现杀手级产品，但这次非常不同。

陈泰铭认为，这次产业结构改变，供货商依旧节制扩产，加上设备交期拉长至14个月到18个月，将使产业景气强度持续较久，不仅对2018年看法乐观，更会延续到2019年。

陈泰铭认为，这波被动组件需求提升来自产业结构改变，需求端有汽车、智能型手机、物联网、扩增实境（AR）、高速运算等多类型的新应用，随着功能提升，对被动组件使用量骤升。

陈泰铭看好这一波景气强度可持续到2019年，尤其车用、工规等高端需求拉升，价格是一般品的2~2.5倍，引导日、台标准型产能投入该领域，这些转向的产能不会回头，加上制造商扩产趋于理性，都让景气持强。

存货水位是被动行业的关键指针，陈泰铭指出，国巨自2016年开始B/B值就在1.1以上，这代表每个月少3天库存，一年下来库存少了36天，嗅出存货水位直线下滑的趋势，国巨因此2016年第4季启动扩产计划，当时设备交期约6~9个月，到现在交期已经延长至14~18个月，此也是景气乐观的理由。

陈泰铭表示，国巨早于2016年底就看到需求提升，而提早规划扩产，近三年的资本支出规模达到120亿元新台币，是过去五年总和。

陈泰铭说，该公司芯片电阻去年底每月芯片电阻产能是900亿颗，今年9月会达到1,200亿颗，日、美同业加起来仍不及一半；而积层陶瓷电容（MLCC）去年第4季的月产能是400亿颗，今年第3季底至第4季初会达到500亿颗。

（资料来源：集微网）

中车时代电气 IGBT 再度中标印度订单

集微网消息，中车株洲所发布信息称，该公司旗下中车时代电气的IGBT模块产品近日击败国际竞争对手，再次获得印度订单，这是截至目前中车时代

电气 IGBT 在国外获得的最大订单。这也意味着中国自主研发生产的 IGBT 产品在海外市场运行稳健，逐步得到国际市场的认可。

中车时代电气半导体事业部总经理吴煜东介绍，此次中标的订单产品总数量超过 1000 只，这批产品将供应给印度一家变流器生产厂家，主要用于 105 台印度机车上。

2016 年，中车时代电气 800A/1700V 的 IGBT 模块凭借优良的产品性能，拿下了第一批 100 台印度 WAG-9 机车的改造升级订单，这也是中国铁路行业最核心器件首次获得海外批量订单。

一年多来，中车时代电气提供的 IGBT 模块装车运行状况良好，获得了客户的高度认可。事实上，这种 800A/1700V 标准的 IGBT 模块，出口前已在重庆机务段 HXD1C 型机车以及昆明等国内近 10 条城市轨道交通线路中运行，成功经历了严峻的市场考验，特别是在我国西部地区坡陡、弯大、隧道多的复杂工况下，表现出了极高的性能及可靠性。

新订单的获得，标志着中国自主研发生产的 IGBT 产品在海外市场运行稳健，逐步得到国际市场的认可，打开了自主芯片占领国际市场的又一新局面。而随着“一带一路”的推进，中国铁路及其高端装备行业走出国门的步伐进一步加快，中车时代电气也加快了在印度、俄罗斯等地海外市场的布局。

（资料来源：集微网）

大反转！Cree 3.45 亿欧元并购英飞凌射频功率业务

集微网消息，总部位于美国的科锐（Cree）周二宣布以约 3.45 亿欧元（约 4.28 亿美元）收购英飞凌（Infineon Technologies）的射频功率（Radio Frequency Power）业务。交易 3 月 6 日生效。

超级反转，卖方变买方

2016 年 7 月 15 日，英飞凌宣布将以 8.5 亿美元的现金收购 Cree 旗下的 Wolfspeed 公司。当时发出这个报道后，业界都认为英飞凌在全球的“商业帝国”越来越大，而在碳化硅领域也将实现“一家独大”的场面。

进而在 2017 年 2 月 17 日，Cree 正式发布声明称将终止 Wolfspeed 电源和 RF 部门出售案件。缘由是美国审查主管机关（CFIUS）认为此项并购案将构成美国国家安全风险，Cree 和英飞凌无法确定解决 CFIUS 关注的国家安全问题的替代方案，因此，双方拟议的交易被终止。Wolfspeed 生产的装置采用具军事用途的 GaN。DLA Piper LLP 监管律师 Brian Chilton 指出，这件事说明美国政府将保护国防工业高度重视的技术，美国不想丧失优势、因此不管收购方是德

国厂商或中国厂商都会予以回绝。

没想到一年后，Cree 由之前的出售，变为现在的主动出击，动作之快让人措手不及。Cree 和英飞凌在技术、协作和共享商业利益方面拥有悠久的历史。

Cree 与英飞凌都是行业内领先的科技公司，各有所长。此次通过收购吸收英飞凌射频功率的团队和技术将扩充 Wolfspeed 现有的产品和技术，如产品设计、包装、制造和客户支持服务等。英飞凌则继续推动关键增长领域，如电动汽车，自动驾驶，可再生能源等。

Cree 首席执行官 Gregg Lowe 表示：“此次收购强化了 Wolfspeed 在 RF GaN on-SiC 技术领域的领导地位，并提供了进入更多市场、客户和封装技术的机会。”他说，“这是 Cree 增长战略的一个关键因素，并定位 WolfSpeay，以实现更快的 4G 网络和向 5G 的革命性过渡。”这笔交易扩大了 Cree Wolfspec 业务部门的无线市场机会。其目标是在收购后的头十二月内增加 1 亿 1500 万美元的年收入。

收购完成后，英飞凌 RF Power 业务将成为 Cree Wolfspeed 运营的一部分。Cree 表示，预计该交易将在收购后的头 12 个月内增加约 1.15 亿美元的年收入，并在第一季度完成对非 GAAP 收益的增长。

交易包括：

英飞凌在美国加州 Morgan Hill 的资产，当中包括了 LDMOS 和 GaN-on-SiC 的封装和运营；

拥有良好客户基础和领先无线基站制造设备经验的工厂、员工和驻点的支持人员；

在美国 Morgan Hill、Chandler，芬兰、瑞典、中国和南韩等地区的约 260 名员工；

该交易还包括一个过渡服务协议，以确保业务连续性和平稳过渡，英飞凌将在大约未来 90 天内大幅执行所有业务操作。

英飞凌将会持续向 Cree 提供 LDMOS 晶圆和相关元器件，将与 LDMOS 晶片及相关部件达成长期供应协议，该协议将在德国雷根斯堡的工厂外提供，并将在其位于马来西亚马六甲的工厂内提供组装和测试服务。

（资料来源：集微网）

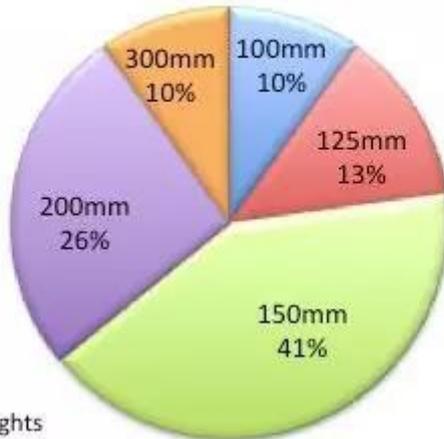
近 9 年全球 92 座 IC 晶圆厂关闭或移为他用 利于代工模式发展

集微网消息，调研机构 IC Insights 最新公布资料显示，2009~2017 年，全球已共有 92 座 IC 晶圆厂关闭或变更用途。其中 6 英寸厂数量占比最高，达 41%。

其次为 8 英寸厂的 26%。4 英寸、5 英寸与 12 英寸厂数量占比则是分别为 10%、13% 与 10%。

Fab Closures by Wafer Size (2009-2017)

100mm 125mm 150mm 200mm 300mm

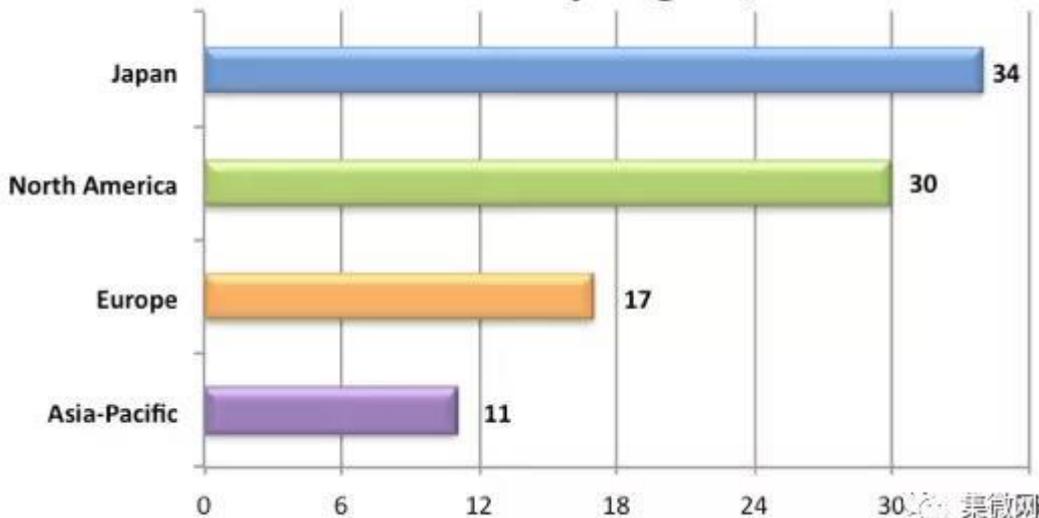


Source: IC Insights

集微网

就地域而言，以日本地区 34 座(占总数 37%)为最多。其次为北美地区的 30 座(占 33%)。欧洲与除日本外亚太地区(APeJ)则是分别有，17 座(占 18%)与 11 座(占 12%)晶圆厂关闭或移为他用。

Wafer Fab Closures by Region, 2009-2017



Source: IC Insights

集微网

再就关闭时间而言，先前受到全球经济衰退影响，2009 与 2010 年全球关闭的晶圆厂数量为最多，分别达 25 座与 22 座。2012 年和 2013 年关闭 10 座，

2015 年关闭 2 座。2017 年则是有 3 座晶圆厂停产。

此外，现有资料显示，2018~2019 年还会有 3 座 IC 晶圆厂关闭(2 座 6 英寸厂，1 座 8 英寸厂)。

在 12 英寸厂方面，2009 年因破产而被德州仪器(TI)收购的德国 DRAM 厂商奇梦达(Qimonda)，是最先关闭 12 英寸晶圆厂的厂商。2013 年台湾茂德(ProMOS)关闭了 2 座 12 英寸存储器晶圆厂。2014 年瑞萨电子(Renesas Electronics)将自家 12 英寸逻辑 IC 厂脱手给 Sony，接着 Sony 将该厂移作生产影像感测器。

2017 年三星电子(Samsung Electronics)也将自家位于韩国龙仁的 Line 11 12 英寸存储器晶圆厂，转用于生产影像传感器。

自 2008~2009 年全球经济衰退爆发以来，IC 厂商为提高晶圆生产成本效益，一直在努力减少 8 英寸(含)以下晶圆产能，并转往更大尺寸晶圆制程发展。而在半导体厂商间兴起的购并浪潮，以及朝向 20 纳米以下制程的发展，也有助于半导体制造厂商淘汰低效能晶圆厂。

此外，随着越来越多 IC 厂商营运模式转变，预期未来还会有更多的晶圆厂关闭，这将会有助于晶圆代工厂商的发展。

IC Insights 表示，随着近来半导体产业收购案频传，新设晶圆厂和晶圆制造设备成本暴涨，再加上越来越多的 IC 厂商朝向轻晶圆厂(Fab-Lite)或纯 IC 设计(fabless)厂商方向发展，预期还会有更多晶圆厂关闭。这对晶圆代工厂商而言，无疑会有助于未来代工业务的发展。

(资料来源：集微网)

硅晶圆涨价不止，客户抢签长期合约以确保产量

集微网消息，市场研究机构 IHS Markit 日前预计 2018 年半导体产业整体晶圆面积将成长 4.5%，NAND SSD 将会是主要成长动能来源之一，DRAM 市场也呈现上升趋势。此外，汽车业与工业应用也是当前的成长来源。

2 月 5 日，美光科技(Micron)宣布调高 2018 会计年度第 2 季(截至 2018 年 3 月 1 日为止)财测，据嘉实 XQ 全球赢家系统报价显示，美光科技 3 月 5 日大涨 5.95%、收 52.03 美元，创 2000 年 9 月 22 日以来收盘新高；今年迄今大涨 26.53%。

从去年初开始，全球半导体硅晶圆产业呈现供不应求而价涨的荣景，相关厂商扩充产能皆有限，市场大多估计这波大好情势至少可延续到 2019 年，甚至是 2020 年，包括 Sumco/信越/LG/Siltronic/环球晶等厂商的后续业绩看旺。

3 月 5 日，德国硅晶圆大厂 Siltronic 发布 2017 年第 4 季财报显示，该公司

营收年增 33.2%(季增 6.5%)至 3.281 亿欧元, 每股盈余(EPS)年增 365%(季增 11.8%)至 2.37 欧元。Siltronic 2017 年营收年增 26.1%至 11.773 亿欧元。

财报显示, 2017 年第 4 季, 12 英寸晶圆(美元计价)以及 Siltronic 整体产品线报价约年增 30%左右。今(2018)年第 1 季度客户对 Siltronic 晶圆的需求依然强劲, 目前包括 12 英寸和 8 英寸晶圆产品生产线均已满载; 6 英寸或更小直径的晶圆产能也非常接近满载。

尽管欧元汇率显著走高, Siltronic 仍预估 2018 年营收将可大幅超越 13 亿欧元、每股盈余预估将大幅走高。Siltronic 执行长 Christoph von Plotho 表示, 硅晶圆报价今年可望持续走高、但涨幅应该小于 2017 年。他还提到, 客户希望提前确保晶圆产量, 因此 Siltronic 已在有利的条件下签订了一些长期合约。

半导体硅晶圆厂表示, 首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂的每片报价再调涨 10%~15%, 12 英寸硅晶圆每片报价站上 90 美元。虽然涨幅略低市场原预估的 20%, 业内人士强调, 未来几季价格还会再调升, 估计全年涨幅将逾二成, 12 英寸硅晶圆每片价格有机会站上 100 美元。他强调, 除 12 英寸硅晶圆缺货, 8 英寸也缺, 甚至随功率半导体需求强劲, 6 英寸供应也吃紧。首季 6 英寸及 8 英寸涨幅不比 12 英寸强劲, 但涨幅也在一成左右, 反应整体硅晶圆供应吃紧, 主要供应商获利可望持续提升。

业界预估, 今年 12 英寸硅晶圆需求有望增加超过 5%, 供给方面, 因设备交期至少需要 1 年以上, 产能增加速度缓慢, 恐将影响供需缺口自去年的 1.5%至 2%, 进一步扩大到今年的 3%至 4%水准。(校对/刘洋)

(资料来源: 集微网)

部份关键设备停产 8 英寸晶圆代工价格逐季调涨

受到关键设备陆续停产, 加上二手设备市场供不应求, 且难以完整兜出完整生产线, 今年 8 英寸晶圆代工产能全年吃紧已难避免。加上今年硅晶圆价格看涨, 多数上游 IC 设计厂或 IDM 厂对 8 英寸晶圆代工价格逐季调涨已有高度共识, 法人看好世界先进受惠最大。

世界先进去年产能利用率几乎维持满载投片, 但受到新台币兑美元汇率升值影响, 全年合并营收年减 3.6%达 249.10 亿元, 归属母公司税后净利年 18.7%达 45.05 亿元, 每股净利 2.75 元, 符合市场预期。

但由世界先进去年季度营运来看, 可看到毛利率及获利表现在下半年明显好转情况, 主要是产品组合改变, 毛利率较高的电源管理 IC 占营收比重拉升, 如去年第四季电源管理 IC 占比已达 54%。法人预期今年电源管理 IC 营收占比过半将成常态, 有助于毛利率的回升。

世界先进目前 MOSFET 接单维持强劲，新增 LED 驱动 IC 客户，加上 IDM 厂的电源管理 IC 委外订单维持高档，目前高压制程及 BCD 制程等产能均满载，元月合并营收 21.30 亿元较去年同期成长 8.0%。法人表示，8 英寸晶圆代工产能全年吃紧，加上硅晶圆价格看涨，世界先进与客户协商后已小幅调涨第一季晶圆代工价格，由于产能全年供不应求，价格应可逐季调涨。

8 英寸晶圆代工产能吃紧原因，主要是 8 英寸晶圆制造的部份关键设备停产，二手设备市场也买不到完整的设备，更别说要兜出完整的 8 英寸晶圆生产线几乎不可能。在此一情况下，8 英寸晶圆厂要扩增产能的难度提升不少，但今年包括 MOSFET、电源管理 IC、指纹辨识 IC、MCU 等都需要更多 8 英寸晶圆代工产能支援，在僧多粥少的情况下，业界对于 8 英寸晶圆代工价格逐季调涨已有高度共识。

世界先进董事长方略日前指出，包括物联网、感测器、电源管理 IC 等应用市场需求不断成长，但 8 英寸晶圆代工产能却没有大幅增加，今年 8 英寸晶圆代工产能将更为吃紧，世界先进可望维持高产能利用率。世界先进评估建置第 4 座晶圆厂，只是现在设备商停产 8 英寸晶圆制造设备，很难买到足够建置整座 8 英寸厂的设备。

法人看好世界先进今年营运表现，由于产能利用率预期将全年满载，加上晶圆代工价格逐季调涨，预估全年营收可望较去年成长 1 成以上，毛利率更有机会明显提升并回到 2014 年水准，全年获利将超过 60 亿元。世界先进不评论法人预估的财务数字。工商时报

(资料来源：集微网)

3、显示面板&LED

传三星 OLED 面板产能利用率降到 50%至 60%

集微网消息，中国面板厂的产量大幅增加，韩国面板厂再也无法光靠规模取得优势，加上电视机和智能手机屏幕的销量疲软，韩国面板厂叫苦连天。

南韩媒体 BusinessKorea 报导，面板市调机构 WitsView 日前表示，今年来液晶显示器 (LCD) 面板的价格一路走低，以 65 英寸超高画质 (UHD) 电视面板为例，去年底报价跌至 354 美元后，1 月跌到 343 美元，2 月报 331 美元，3 月初进一步降至 315 美元。

这些发展对乐金显示器公司 (LGD) 的冲击特别大。在去年大电视面板市场中，乐金显示器的市占率最高，市调机构 IHS Markit 的数据是占 19%，而这个部门对于大举投资有机发光二极管 (OLED) 面板的乐金显示器来说，早已是摇钱树。

但随着中国面板制造商强攻 LCD 面板市场，业界愈来愈担心价格下滑的问题。也因此，乐金显示正器全力压低成本。

中小尺寸面板的情况看起来也不太妙，苹果公司 iPhone X 卖不动，重创三星显示器公司。原本三星显示器还指望 iPhone X 能带动 OLED 面板销量，结果事与愿违。一些专家估计，三星显示器的产能利用率降到 50% 至 60%。

高盛集团分析师更下修三星电子从会计年度 2018 年至 2020 年的获利预估，原因是媒体报导上半年 iPhone X 的产量计划不如预期，且中国智能手机制造商对 OLED 面板的需求也没预期强。

(资料来源：集微网)

确保优势，京东方拟近千亿元投建第 6 代 AMOLED 生产线等三项目

集微网消息，京东方再砸近千亿元投建 AMOLED/TFT-LCD 新产线。3 月 8 日晚间，京东方发布公告称，公司拟投资 465 亿元，在重庆两江新区建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目，主要产品定位为 AMOLED 高端手机显示及新兴移动显示产品。

据披露，重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目建在重庆两江新区，占地面积为 1,009.34 亩，主要为手机、车载及可折叠笔记本等提供柔性显示产品，玻璃基板尺寸为 1,500mm×1,850mm，设计产能为 48K/月，项目建设周期为 28 个月。

该项目公司为重庆京东方显示技术有限公司，项目公司注册资本 260 亿元，其中 160 亿元由重庆市人民政府和/或其指定投资平台负责筹集，100 亿元由公司负责筹集。项目总投资 465 亿元和项目公司注册资本 260 亿元的差额部分，通过外部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

京东方表示，本项目为公司在 AMOLED 领域的又一重大战略布局，是实现 AMOLED 显示器件产业化的一个重要里程碑，符合公司未来的发展规划。项目投产后将进一步提升公司的整体技术水平，全屏手机、车载及可折叠笔记本等高附加值产品将相继量产，通过与成都建设的第 6 代 AMOLED(柔性)生产线和绵阳建设的第 6 代 AMOLED(柔性)生产线的协同效应，不仅能够提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性 AMOLED 领域的市场占有率，更有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力，巩固同国内外品牌客户的合作，拓展更大的市场空间及应用领域，对于争取全球半导体显示产业主动权，进一步提升公司盈利能力具有重要意义。

除了 AMOLED 产线外，随着 TFT-LCD 显示技术在电视领域的渗透率不断攀升，屏幕尺寸大型化成为未来的发展趋势。京东方也同时宣布拟投资 460 亿元，在武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项

目及配套项目，主要产品为 65 英寸与 75 英寸的 4K/8K、60Hz/120Hz 电视面板产品，设计产能为 12 万张/月，项目建设周期为 24 个月。

京东方表示，该产线项目定位于 65 英寸、75 英寸等超大尺寸、高分辨率、高附加值产品，有助于应对该细分市场的快速发展，满足大尺寸高端市场需求的增长；有助于提升公司总体规模、公司液晶显示屏产品的综合竞争力，巩固公司在半导体显示技术和产品方面的先发优势和在半导体大尺寸显示领域积累的产业优势，确保公司在 65 英寸以上半导体显示领域占据国际领先优势。

此外，京东方还同时宣布拟投资 40.23 亿元，于苏州市投资打造京东方(苏州)产业园项目。产业园项目包括京东方(苏州)智造服务产业园项目以及适时启动的其他产业项目。

京东方表示，该智造服务产业园项目通过扩产改造升级、促进产业聚集，有助于公司发挥资源整合能力，落实物联网战略应对智能制造发展趋势，抓住新应用智慧终端的市场需求，推动智造服务事业转型升级，提升智造服务事业群的盈利力和综合竞争力。同时，随着智造服务产业园自动化、信息化程度进一步提高，有利于降低人工成本，提高效率和品质，为公司未来实施更高层次的智能制造积累经验。(校对/范蓉)

(资料来源：集微网)

人工智能新应用，LG 将推出内建 AI 架构 OLED 电视

根据韩国媒体《ETNEWS》的报导，韩国电视大厂 LG 将推出内含 AI 架构的 OLED 电视。该系列内建 AI 架构的 OLED 电视，预计在 2018 年内推出 10 种机款。而由于价格相较之前的 OLED 电视有所下降，而且具备 AI 架构的情况下，市场预计推出后将受到重视。

报导指出，该系列内含 AI 架构的 OLED 电视采用 LG 自行研发的 Alpha 9 智能处理器，其 CPU 及 GPU 的运算能力较以往处理器提高 35%，并配备 4 步骤杂讯抑制、“进阶映射”(Advanced Mapping)及改进颜色校正运算法，让画面的清晰度、颜色、渐变层次都有较以往更佳的表现。

另外，除了在色彩与画质的控制上，透过 Alpha 9 智能处理器的处理，有更好的表现之外。在使用者界面上，也能透过 Alpha 9 智慧处理器，利用自然语言语音辨识来控制音量、改变频道，预约广播收看、预约 TV 关闭等，并且改变影片观赏模式(如电影，运动，游戏等)，可为影片类型提供最佳的观赏品质和声音效果；甚至还可以透过建置在遥控器上的话筒，说出电视台和节目名字进行搜索点播，并用于预约节目和查询演员讯息等。

据了解，LG 将推出内含 AI 架构 OLED 电视的 10 款新机型中，共区分为屏幕尺寸 55 寸、65 寸和 77 寸等地 3 种规格。预计售价为 55 寸机型

为 300 万韩元（约合人民币 1.8 万元）起。而因为鸿海集团旗下的夏普也正在进行内建 AI 架构的电视开发与销售。因此，预计未来 LG 的产品推出后将会受到市场瞩目。TechNews

（资料来源：集微网）

LG 冲刺 OLED 电视，今年销售占比提高至 20%

乐金电子周一表示将进一步强化高阶电视机业务，旗下 OLED 电视今年将占公司整体电视销售的 20% 左右。

该公司家庭娱乐事业主管 Kwon Bong-suk 表示，在以 OLED 电视为主的高阶电视市场，乐金电子的成长率已经翻倍，今年也将追求强劲的增长。他表示，未来将扩大 OLED 电视机的销售比重。去年 OLED 电视占乐天电视总销量的 15%。

该名主管表示，电视机终将成为人工智能（AI）平台的枢纽，短期内音响可以作为连接和控制各种非 AI 装置的桥梁，但长期而言，在客厅安装的 AI 电视机将扮演这个角色，因此乐金电子将与合作伙伴联手，提供不同的 AI 服务。

他举例，可透过 AI 电视机订餐和启动其他电子装置。不过他表示，乐金电子不会投入制作电影和戏剧等内容事业。

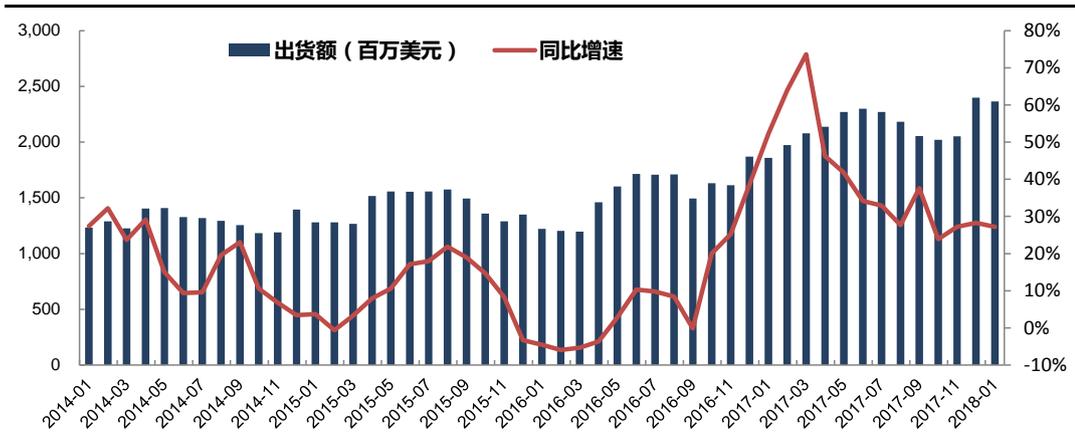
Kwon Bong-suk 表示，到 2021 年以前乐金电子每年可生产约 1000 万台 OLED 电视机，相当于约 5% 的全球电视市场。谈及美国总统川普主张的贸易保护主义，该主管表示，美国是高阶电视机的重要市场，乐金电子已准备好去配合华盛顿当局会采取的任何措施。时报

（资料来源：集微网）

三、产品行情指标

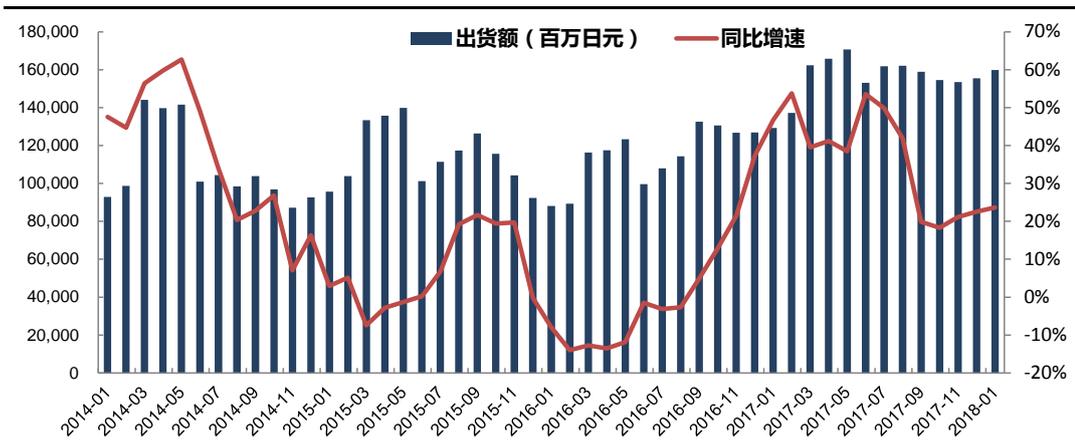
1、半导体方面指标

图表 6: 北美半导体设备出货额 (百万美元)



数据来源: SEMI, wind, 华融证券

图表 7: 日本半导体设备出货额 (单位: 百万日元)



数据来源: SEAJ, wind, 华融证券

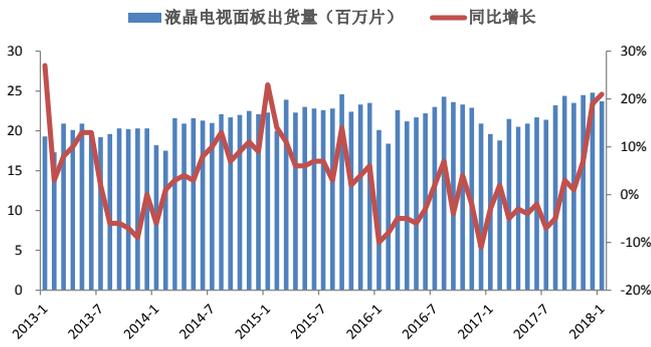
图表 8: 全球半导体月销售额



数据来源：SIA, wind, 华融证券

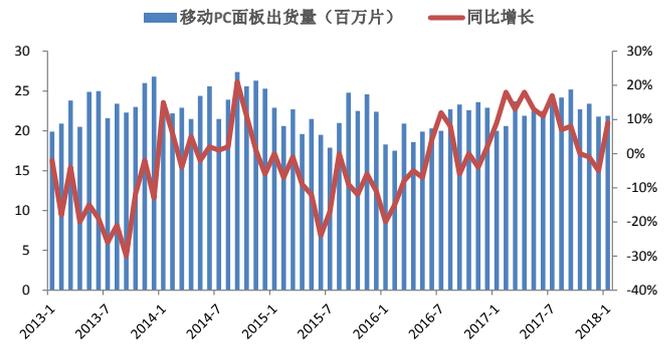
2、面板方面指标

图表 9：全球液晶电视面板出货量



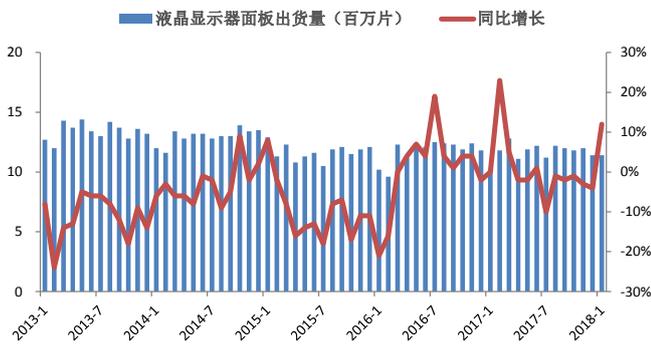
数据来源：wind, 华融证券

图表 10：全球移动PC面板出货量



数据来源：wind, 华融证券

图表 11：全球显示器面板出货量



数据来源：wind, 华融证券

3、消费电子方面指标

图表 12: 全球PC出货量



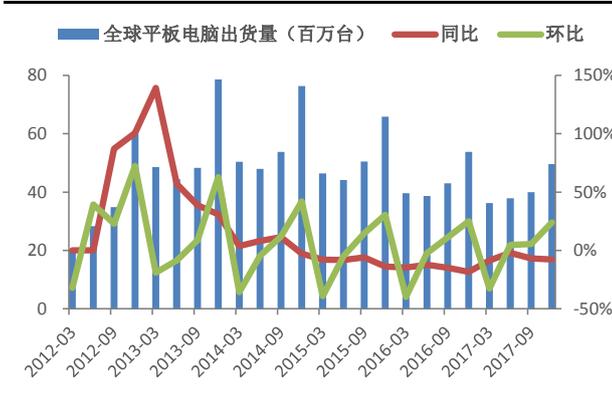
数据来源: Gartner, wind, 华融证券

图表 13: 全球智能手机出货量



数据来源: Gartner, wind, 华融证券

图表 14: 全球平板电脑出货量



数据来源: Gartner, wind, 华融证券

四、投资策略

我们首先看好半导体板块, 重点为被动元器件、上游材料设备、下游封测板块; 其次看好安防、智能硬件等板块。

五、风险提示

行业景气度衰竭; 宏观经济复苏弱于预期; 市场震荡与风格切换引起的估值变化

投资评级定义

公司评级		行业评级	
强烈推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15% 以上	看好	预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5% 以上
推 荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5% 到 15%	中性	预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平
中 性	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在 -5% 到 5% 内	看淡	预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5% 以上
卖 出	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15% 以上		

免责声明

庞立永, 在此声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。华融证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。华融证券股份有限公司(以下简称本公司)的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策。本报告仅提供给本公司客户有偿使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告, 但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归本公司所有。未获得本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播, 不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。本报告中的信息、建议等均仅供本公司客户参考之用, 不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求, 必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠, 但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务, 敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响。

华融证券股份有限公司市场研究部

地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 15 层(100020)

传真: 010-85556304

网址: www.hrsec.com.cn